



Tiratura | **Print-run** 8.239

Certificato CSST n. 2008-1771

Diffusione | **Circulation** 7.975

Qualità della diffusione certificata da BVQI (Bureau Veritas Italia)

BVQI CERTIFICATO N.409/001 rilasciato in data 17/03/2009

Mensile 11 numeri (numero unico Luglio/Agosto)
Monthly 11 issues (July/August: combined issue)

Data pubblicazione | **Issue date**
1^a settimana del mese
First week of each month

Tipo di stampa | **Printing process**
Offset piana / Web offset

Rivista Ufficiale di **di:et** Distretto dell'Elettronica e delle Tecnologie Avanzate

Elettronica Oggi è la rivista leader nel settore dell'elettronica professionale -microprocessori, IC analogici e digitali, logiche programmabili, componentistica passiva e packaging- della strumentazione, del software e delle tecnologie che hanno un impatto rilevante sulla vita di tutti i giorni (biotecnologie, nanotecnologie, nanomateriali). Certificata CSST, Elettronica Oggi è distribuita in abbonamento e con mailing list e, prima e unica rivista in Italia a farlo, garantisce la qualità della diffusione mediante certificazione BVQI. La rivista cartacea è completata da Elettronica Oggi Web (www.eo-web.it), l'edizione online di Elettronica Oggi, che contiene le sezioni: Web Exclusive; Hot News; Design Ideas; Point of View.

Elettronica Oggi is the leading magazine in professional electronic -microprocessors, analogic and digital ICs, programmable logics, passive components and packaging-instrumentation, software and the new technologies that deeply impact every day life (biotechnologies, nanotechnologies, nanomaterials).

Elettronica Oggi is distributed upon subscription and through mailing list.

Elettronica Oggi is first and unique Italian magazine CSST and BVQI certified.

The magazine is fulfilled by Elettronica Oggi Web (www.eo-web.it), the Elettronica Oggi online edition, made up by five main sections: Web Exclusive; Hot News; Design Ideas; Point of View.

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date
Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita
Delivery material: 35 days before publication date

LISTINO / LISTINO

Formati	Formats	Euro 4/c	Euro b/n b/w
1/4 pagina	1/4 page	880,00	646,00
1/3 pagina	1/3 page	1.027,00	823,00
1/2 pagina	1/2 page	1.996,00	1.351,00
2/3 pagina	2/3 page	2.231,00	1.645,00
Pagina	Page	2.767,00	2.055,00
Master	Master	8.083,00	-
I romana	Third page	3.212,00	3.212,00
Doppia mezza	Double half page	3.993,00	2.701,00
li copertina	Inside front cover	3.439,00	-
lii copertina	Inside back cover	2.846,00	-
lv copertina	Back cover	5.039,00	-
Doppia pagina	Double page	5.534,00	4.111,00
Cartolina	Post card	1.800,00	1.800,00
Battente cop.	Cover leaf	6.522,00	-
Inserto 2 facciate	Insert 2 front	2.500,00	2500,00
Inserto 4 facciate	Insert 4 front	4.100,00	4100,00
Supplemento colore	Colour supplement	+20%	+20%
Posizioni speciali	Special position	+15%	+15%

NUMERO ISSUE	SPECIALE COVER STORY	AGGIORNAMENTI/APPROFONDIMENTI UPDATE / IN DEPTH	ARTICOLI GENERALI GENERAL ISSUES	FIERE EXHIBITIONS
396 Gennaio January	▶ MCU (directory) (MCU - directory)	▶ Progettazione low-power (Low power design) ▶ IC per Telecom (Telecom ICs)	▶ IC analogici/mixed signal (Analog Mixed signal ICs) ▶ Sensori ottici (Optical sensors) ▶ Strumentazione T&M (T&M Instrumentation) ▶ Nanotecnologie (Nanotechnologies) ▶ Circuiti di protezione (Protection circuits)	Opti, 15-17/01, Monaco (D)
397 Febbraio February	▶ IC di conversione (Conversion ICs)	▶ Illuminazione a stato solido (Solid state lighting) ▶ *R&D in Italia (Italy: the state of R&D)	▶ Potenza digitale (Digital power) ▶ Gestione termica (Thermal management) ▶ Elettromeccanici/Passivi/Connettori (Passive/electromechanics/connectors) ▶ Logiche programmabili (Programmable logic) ▶ Optoelettronica (Optoelectronics)	MC ⁴ -Motion Control for, febbraio, (I) NI Days, 24/02, Roma (I)
398 Marzo March	▶ Strumentazione per test RF/microonde (RF/microwave T&M)	▶ IC di alimentazione (Power supply Ics) ▶ *Strumentazione EDA: trend tecnologici (EDA tool: technology trends)	▶ RF/wireless (RF/wireless) ▶ IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) ▶ Green engineering (Green engineering) ▶ Logiche programmabili (Programmable logic) ▶ Elettronica per automotive (Automotive electronics)	Embedded World, 2-4/03, Norimberga (D) CeBIT, 2-6/03, Hannover (D) Date, 8-12/03, Dresda (D) EMV, 9-11/03, Düsseldorf (D) Electronica & Productronica China / Laser World of Photonics China, 16-18/03, Shanghai (PRC) Smart Systems Integration, 23-24/03, Como (I) PCIM China, marzo, Shanghai (RPC)
399 Aprile April	▶ DSP Directory (Directory DSP) ▶ Speciale Anteprima Bias (Special: Bias preview)	▶ Elettronica di potenza (Power electronics) ▶ *R&D: il ruolo dell'Europa (R&D: the role of Europe)	▶ ASIC/ASSP (ASICs/ASSPs) ▶ Integrità dei segnali (Signal integrity) ▶ Nanotecnologie (Nanotechnologies) ▶ Strumentazione T&M (T&M Instrumentation) ▶ Standard wireless (Wireless standards) ▶ Optoelettronica e fotonica (Optoelectronics & photonics)	Display International, 14-16/04, Tokyo (J) Hannover Messe, 19-23/04, Hannover (D) Embedded Systems Conference Silicon Valley, 26-29/04, San Jose (CA-USA)
400 Maggio May	▶ Soluzioni programmabili (Programmable solutions)	▶ Convertitori c.c./c.c. (d.c./d.c. converters) ▶ Illuminazione a stato solido (Solid state lighting)	▶ Interconnessioni seriali (Serial interconnections) ▶ Energie alternative (Alternative energy) ▶ Nuove tecnologie di memoria (Memory technology) ▶ Passivi/elettromeccanici/connettori (Passives/electromechanics/connectors) ▶ MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors)	PCIM Europe, 4-6/05 - Norimberga (D) TEW (FluidTrans Compomac/Bias/Mechanical Power Transmissions & Motion Control), 4-7/05, Milano-Rho (I)
401 Giugno June	▶ Microprocessori (Microprocessors)	▶ Standard wireless (Wireless standards) ▶ *Elettronica analogica: trend tecnologici (Analog electronics: technology trends)	▶ Interfacce seriali (Serial interfaces) ▶ Strumentazione T&M (T&M instrumentation) ▶ MEMS e sensori avanzati (MEMS and advanced sensors) ▶ IC di gestione della potenza (Power management ICs)	SMT/Hybrid/Packaging, 8-10/06, Norimberga (D) Automatica, 8-11/06, Monaco (D) VforM-Vision for Manufacturing, giugno, (I)
402 Luglio/Agosto July/August	▶ Nuove tecnologie (New technologies)	▶ Materiali per EMC (EMC materials) ▶ Elettronica digitale: trend tecnologici (Digital electronics: technology trends)	▶ Elettromeccanici/passivi/connettori (Electromechanics/passives/connectors) ▶ IC di conversione (Conversion ICs) ▶ Elettronica consumer (Consumer electronics) ▶ Software per la progettazione con Fpga (Fpga development software) ▶ Conservazione dell'energia (Energy harvesting)	NI Week, agosto, Austin (TX-USA)
403 Settembre September	▶ Elettronica di potenza (Power electronics)	▶ IP/SoC (IPs/SoCs) ▶ Compressione dati (Data compression)	▶ Sicurezza dei dati (Data security) ▶ IC analogici/Mixed signal (Analog/Mixed signal ICs) ▶ Strumentazione T&M (T&M instrumentation) ▶ Nuovi materiali per l'elettronica (New materials for electronics) ▶ Energie alternative/rinnovabili (Renewable/alternative energy)	Electronica India, settembre, Bangalore (India) Productronica India, settembre, Bangalore (India) MNE, 19-22/09, Genova (I) Control & Communication, settembre, (I)
404 Ottobre October	▶ Chip multimediali (Multimedia Ics)	▶ Nuove batterie (New batteries) ▶ *Logiche programmabili: trend tecnologici (Programmable logic: technology trends)	▶ Strumentazione T&M (T&M instrumentation) ▶ IC analogici/mixed signal (Analog/mixed signal ICs) ▶ Norme ambientali per l'elettronica (Environmental compliance) ▶ Standard wireless (Wireless standards) ▶ Nanotecnologie (Nanotechnologies)	Maintain, 12-14/10, Monaco (D) Electronic Asia, 13-16/10, Hong Kong (PRC) SPS/IPC/DRIVES Italia, 19-21/10, Parma (I) IA-Industrial Automation Forum, ottobre, (I)
405 Novembre November	▶ Strumentazione per fibre ottiche (Fiber optics T&M)	▶ Tecnologie a larga banda (Broadband technologies) ▶ *DSP: trend tecnologici (DSP: technology trends)	▶ ASIC/FPGA/ASSP (ASICs/FPGAs/ASSPs) ▶ Controllo motori (Motor control) ▶ TV digitale (Digital TV) ▶ Semiconduttori discreti (Discrete semiconductors) ▶ Energie alternative (Alternative energy)	Electronica, 9-12/11, Monaco (D) SPS/IPC/DRIVES, 23-25/11, Norimberga (D) Focus Embedded, novembre, (I)
406 Dicembre December	▶ Tecnologie di visualizzazione (Display technologies)	▶ Dispositivi multicore (Multicore devices) ▶ *Trend tecnologici nell'industria elettronica (Technology trends in electronic industry)	▶ Strategie di collaudo (Test strategies) ▶ Efficienza energetica (Energy efficiency) ▶ Strumentazione T&M (T&M instrumentation) ▶ Nanotecnologie (Nanotechnologies) ▶ Standard wireless (Wireless standard)	

*In cooperazione con eo-web.it / (In cooperation with eo-web.it)

CHI LEGGE ELETRONICA OGGI

Settori di interesse Fields of interest

Industria	Trasporti	
Industry	Transportation	8%
IT, Telecom	Automation	
IT, Telecom	Automation	29%

READERS OF ELETRONICA OGGI

Prog. macchine	Progettazione elettronica	
Machinery design	Electronic design	43%
Componentistica	Ingegneria	
Components	Engineering	17%

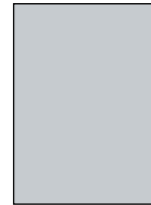
Funzione aziendale Job function

Area ricerca e sviluppo / R&D area	50%	Responsabile e/o tecnico IT	
Direttori marketing e commerciali		IT Manager a/o technician	10%
Sales and marketing team	4%	Consulente, docente	
Responsabili della progettazione		Advisers, tutors	3%
Design managers	16%	Altre funzioni	
Direzione / Top management	15%	Other	2%

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE OGGI
FIELD BUS & NETWORKS
ELETTRONICA OGGI
EMBEDDED
RMO - Rivista di Meccanica Oggi

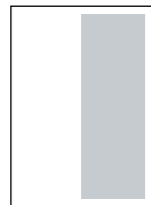
SdA - Soluzioni di Assemblaggio
PROGETTARE
FLUIDOTECNICA
INQUINAMENTO
RICH-MAC CHIMICA NEWS
ENERGIE OGGI



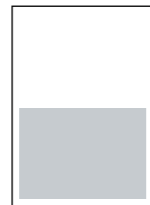
PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
190 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



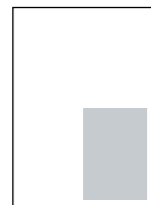
2/3 PAG. VERTICALE
IN GABBIA
2/3 PAGE VERTICAL
(TYPE AREA)
118 X 260 mm



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
100 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



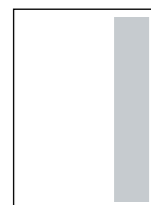
1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
210 X 140 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
190 X 130 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/4 PAG. ORIZZONTALE
1/4 PAGE HORIZONTAL
100 X 130 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 120 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



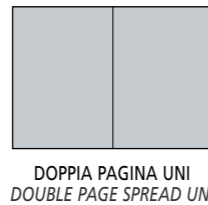
1/3 PAG. ORIZZONTALE
1/3 PAGE HORIZONTAL
210 X 105 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
181 X 90 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/3 PAG. VERTICALE
1/3 PAGE VERTICAL
80 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
56 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



PAGINA INTERA
FULL PAGE
148 X 210
(VIVO + REFILI) / BLEED
125 X 190
(IN GABBIA) / TYPE AREA



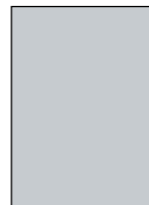
DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
296 X 210
(VIVO + REFILI) / BLEED
270 X 190
(IN GABBIA) / TYPE AREA

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

EO NEWS



DOPPIA KING SIZE
DOUBLE KING SIZE PAGE
530 X 310 mm + REFILI / BLEED
500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE AREA



KING SIZE / KING SIZE
265 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
245 X 290 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



UNI / UNI PAGE
203 X 230 mm
+ REFILI / BLEED
187 X 218 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



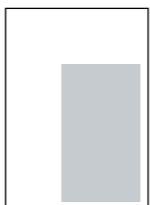
1/2 PAGINA VERTICALE
1/2 PAGE VERTICAL
132 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 262 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



1/2 PAGINA ORIZZONTALE
1/2 PAGE HORIZONTAL
265 X 154 mm
+ REFILI / BLEED
235 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



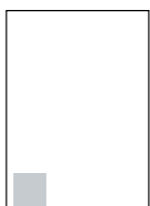
1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE
133 X 155 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



JUNIOR / JUNIOR
154 X 201 mm
+ REFILI / BLEED
140 X 183 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



MANCHETTE 1° COPERTINA
79 X 61 mm
MANCHETTE NEWS
91 X 61 mm



SPAZIO MERCATO
78 X 78 mm

DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA
1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE



DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
420 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
90 X 240 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
180 X 125 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

- IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm
SENZA REFILI
- FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm
BLEED

SPECIFICHE TECNICHE PER IL MATERIALE DI STAMPA

Formati: formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi) ottimizzato per la stampa, più 3 mm per lato di refilo.

Supporti: CD, Server Sharepoint di Fiera Milano Editore
N.B: non inviare i file per posta elettronica.

Le lavorazioni di materiali non conformi alle specifiche sopra citate sia tecniche che di formato saranno fatturate forfettariamente (€ 50,00).

DETAILS FOR PRINTING MATERIAL

Formats: PDF format in highest resolution (300 dpi) ready for printing, with 3 mm of space at perimeter.

Supports: CD, Sharepoint Server of Fiera Milano Editore
N.B: do not send any file by e-mail.

Any modification of materials not conforming to the a.m. technical and size details will be invoiced at a forfait cost (€ 50,00).

Giuseppe De Gasperis

Sales Manager - Divisione Technology

Fiera Milano Editore SpA - Divisione Technology

Viale Espinasse, 141

20156 Milano

Tel. +39 02 36 60 92 523

Fax +39 02 36 60 92 524

Mobile +39 34 87 14 67 48

E-mail: giuseppe.degasperis@fieramilanoeditore.it

Siti web: www.ilb2b.it - www.fieramilanoeditore.it

WORLDWIDE ADVERTISING sales offices

U.K. - SCANDINAVIA - NETHERLAND AND BELGIUM:

The Huson European Media - Gerry Rhoades-Brown

tel.: +44 1932 564999 - fax: +44 1932 564998

SWITZERLAND: Agentur Iff - Bernard Kull

tel.: +41 52 6330888 - fax: +41 52 6330899

GERMANY AND AUSTRIA: Media Agentur - Adela Ploner

tel.: +49 8131 3669920 - fax: +49 8131 3669929

USA: The Huson International Media USA - Ralph S. Lockwood

tel.: +1 408 8796666 - fax: +1 408 8796669

TAIWAN: Worldwide Services co. Ltd, Mr Robert Yu

tel.: +886-4-23251784 - fax: +886-4-23252967